

锦州神工半导体股份有限公司

2021 年年度业绩预告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 21,000.00 万元到 23,000.00 万元。与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 10,972.35 万元到 12,972.35 万元，同比增长 109.42%到 129.37%。

● 预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 20,570.00 万元到 22,570.00 万元；与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 11,605.56 万元到 13,605.56 万元，同比增长 129.46%到 151.77%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 21,000.00 万元到 23,000.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 10,972.35 万元到 12,972.35 万元，同比增加 109.42%到 129.37%。

2、预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 20,570.00 万元到 22,570.00 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 11,605.56 万元到 13,605.56 万元，同比增加 129.46%到 151.77%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2020 年度，公司归属于母公司所有者的净利润为 10,027.65 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 8,964.44 万元。

三、本期业绩变化的主要原因

2021 年度，公司预计归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期有变化的主要原因如下：

（一）全球集成电路产业蓬勃发展，景气度持续提升，根据 SEMI 统计，2021 年集成电路制造厂设备支出增长 39%左右。根据最新披露刻蚀机领域设备厂商数据显示，TEL 上半财年半导体制造设备销售相比去年同期增长 42.5%，LAM 2021 年前三季度芯片制造系统销售相比去年同期增长 45.5%。受此影响，公司刻蚀机用大直径单晶硅材料订单需求大幅增加，营业收入较上年同期实现较大幅度增长。

公司预计 2021 年全年实现营业收入 44,600.00 万元至 50,200.00 万元。与上年同期 19,209.75 万元相比，将增加 25,390.25 万元至 30,990.25 万元，同比增长 132.17%至 161.33%。

（二）公司根据市场需求优化产品结构，利润率较高的 16 英寸及以上大直径单晶硅材料销售收入进一步提升，对净利润增长有较大贡献。

（三）在产品成本、良品率、参数一致性等关键指标上，公司继续提升其全球竞争优势。在此基础上公司及时地增加了大直径单晶硅材料的产能规模，提高了对客户的稳定供货能力。

（四）公司预计 2021 年全年研发费用为 3,200.00 万元至 3,800.00 万元。与上年同期 1,790.11 万元相比，增加 1,409.89 万元至 2,009.89 万元，同比增长 78.76%至 112.28%。为推进公司半导体级 8 英寸轻掺低缺陷抛光硅片业务发展，研发费用较上年同期有较大增幅，有利于实现公司的长期战略规划。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2022 年 1 月 25 日